

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



交通銀行股份有限公司

Bank of Communications Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03328)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列交通銀行股份有限公司於上海證券交易所網站及中國報章刊登的《交通銀行股份有限公司關於對國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司投資的公告》，謹供參閱。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
何兆斌
公司秘書

中國上海
2024年5月27日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、殷久勇先生、周萬阜先生、李龍成先生*、汪林平先生*、常保升先生*、廖宜建先生*、陳紹宗先生*、穆國新先生*、陳俊奎先生*、羅小鵬先生*、蔡浩儀先生#、石磊先生#、張向東先生#、李曉慧女士#、馬駿先生#及王天澤先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2024-018



交通银行股份有限公司 关于对国家集成电路产业投资基金三期 股份有限公司投资的公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本公司近日已签署《国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司发起人协议》（以下简称“《发起人协议》”），拟向国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司（以下简称“基金”）出资人民币 200 亿元（以下简称“本次投资”）。
- 本次投资已经本公司董事会审议通过，无需提交本公司股东大会审议。
- 本次投资已经国家金融监督管理总局批准。

一、本次投资概述

近日，本公司与中华人民共和国财政部等 19 家机构签署《发起人协议》，拟向基金出资人民币 200 亿元，持股比例 5.81%，预计自基金注册成立之日起 10 年内实缴到位。

本次投资不属于本公司重大资产重组事项，不构成本公司的关联交易。

本次投资已于 2023 年 10 月 27 日经本公司董事会审议通过。议案表决情况：

有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于本公司董事会审议通过上述议案时，本次投资尚未完成协议签署，基金尚未设立，存在不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《交通银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的有关规定，本公司经审慎判断，决定暂缓披露本次投资，并按相关规定办理了暂缓披露的内部登记和审批程序。

本次投资无需提交本公司股东大会审议。

本次投资已经国家金融监督管理总局批准。

二、投资标的基本情况

基金由中华人民共和国财政部等 19 家机构共同出资设立，注册资本为人民币 3,440 亿元，经营范围包括私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询等。基金旨在引导社会资本加大对集成电路产业的多渠道融资支持，重点投向集成电路全产业链。

三、本次投资对本公司的影响

本次投资资金来源为本公司自有资金。本次投资是本公司结合国家对集成电路产业发展的重大决策、本公司的发展战略及业务资源作出的重要布局，是本公司服务实体经济、推动经济和社会可持续发展的战略选择，是本公司践行大行担当的又一大举措，对于推动本公司业务发展具有重要意义。

四、本次投资的风险分析

根据《发起人协议》约定，本公司应自基金注册成立之日起 10 年内按照认购的股份全额缴纳股款，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（2024 年 7 月 1 日实施）等相关法律法规，上述出资期限安排尚需根据法律法规取得相关部门同意。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2024年5月27日